

易華電子股份有限公司



股票代號：6552

2022/11/29

本簡報中對產業未來的展望為反映本公司截至目前為止的看法，未來若有任何變更或調整時，本公司並不負責隨時提醒或更新。



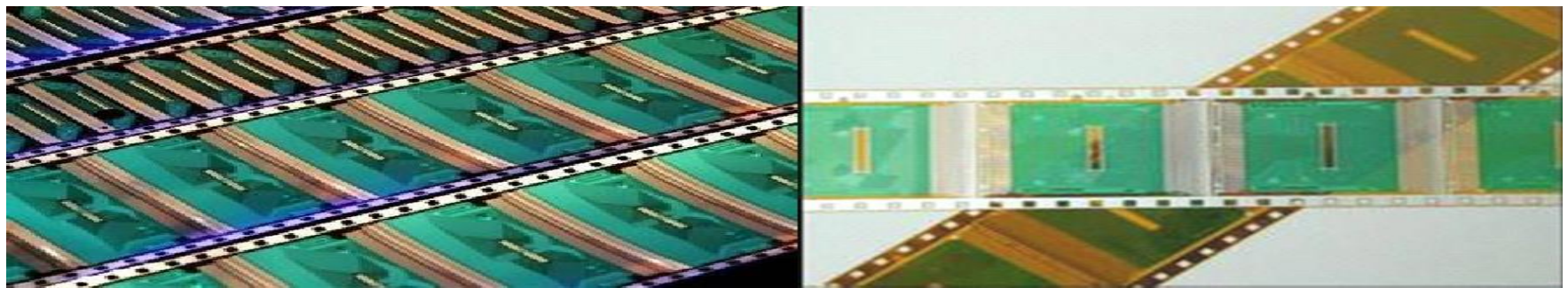
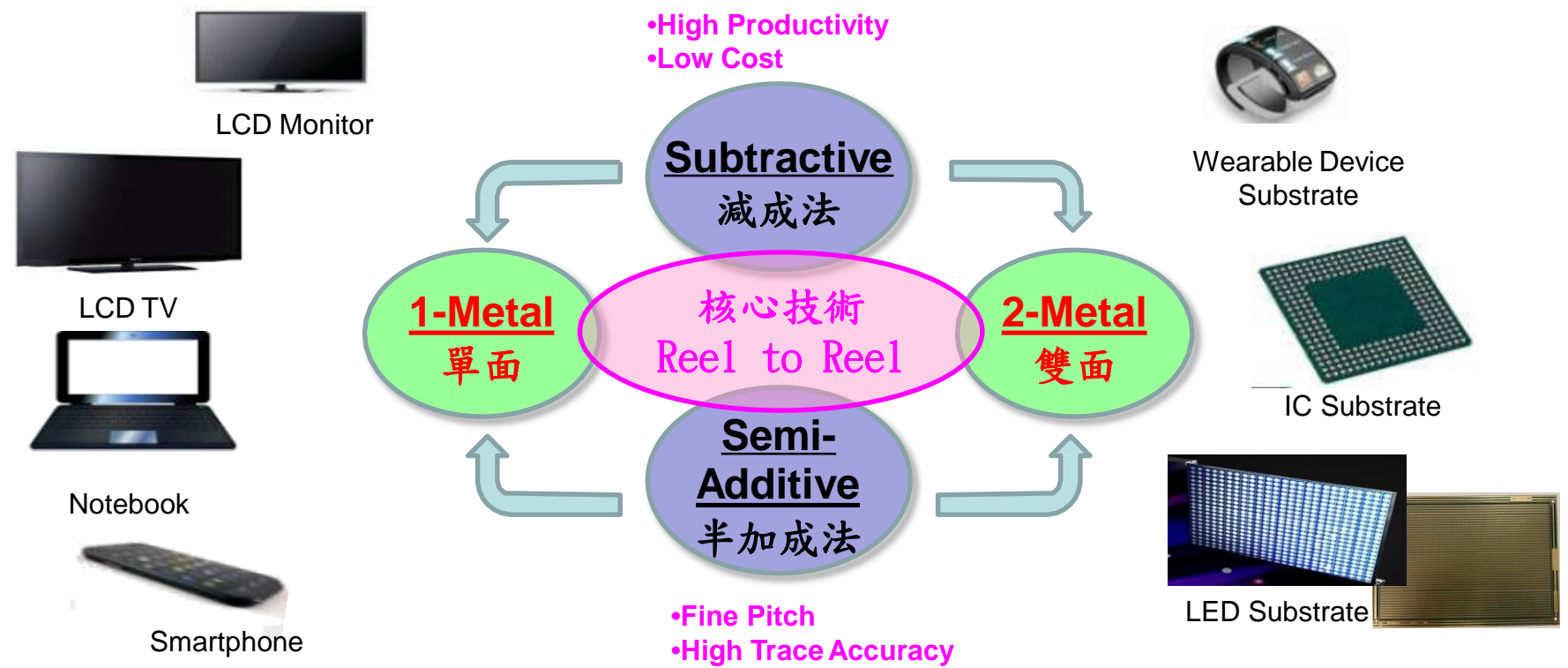
-Professional Reel-to-Reel Fine-Pitch Service

一、公司概况-基本資料

- 公司設立：1973年10月6日(原名台灣住礦電子股份有限公司)
- 董事長：黃嘉能
- 總經理：李宛霞
- 實收資本：新台幣8.3億元
- 主要股東：長華42%、南茂10%
- 員工人數：587人(截至2022年10月底)
- 主要產品：捲帶式高階覆晶薄膜IC基板(Reel to Reel Chip on Film)
- 地 址：高雄市楠梓區新開發路8號



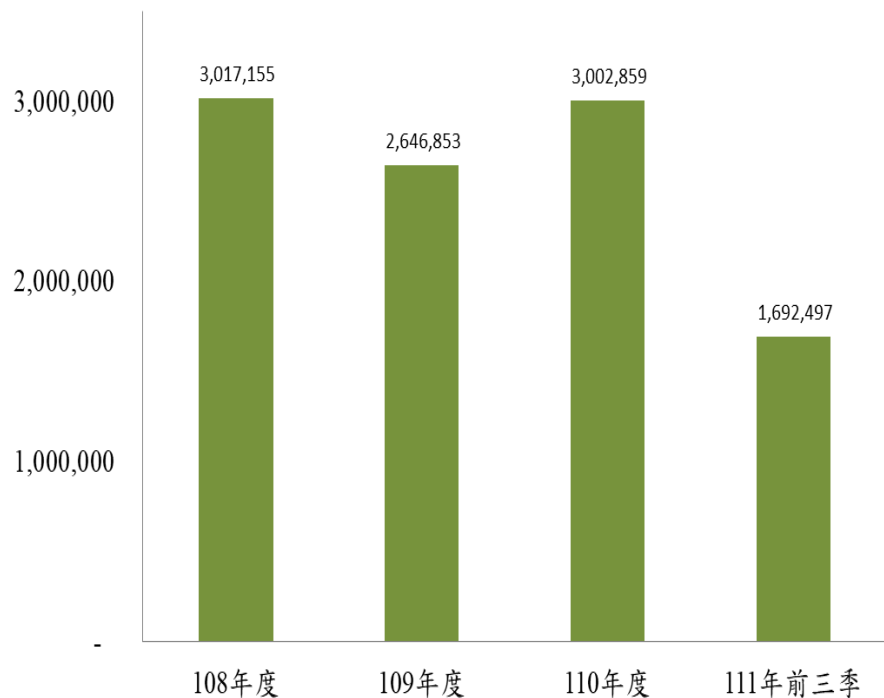
一、公司概況-產品應用



二、營運績效-歷年營收及獲利

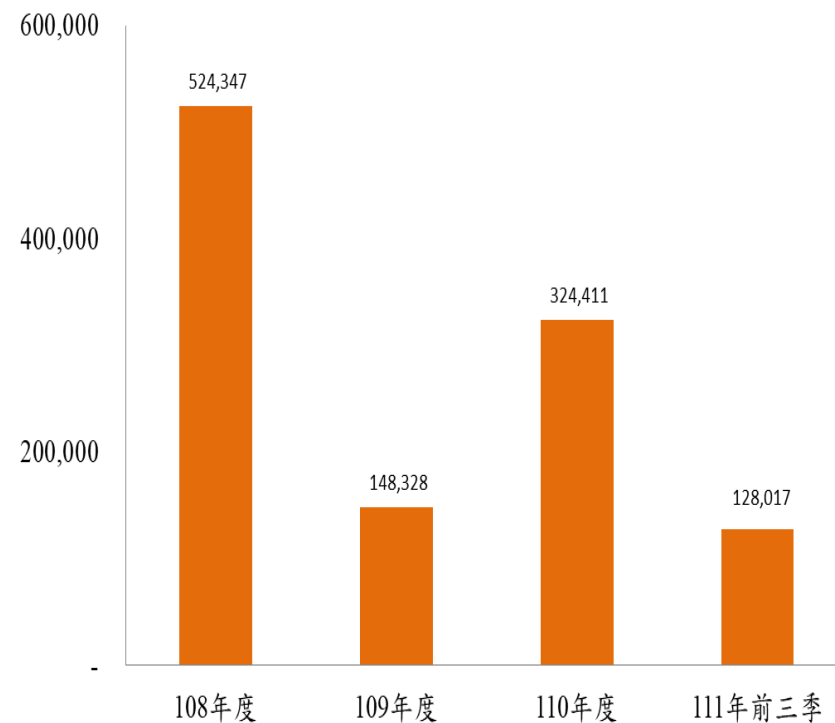
單位:仟元

營業收入



單位:仟元

稅後純益

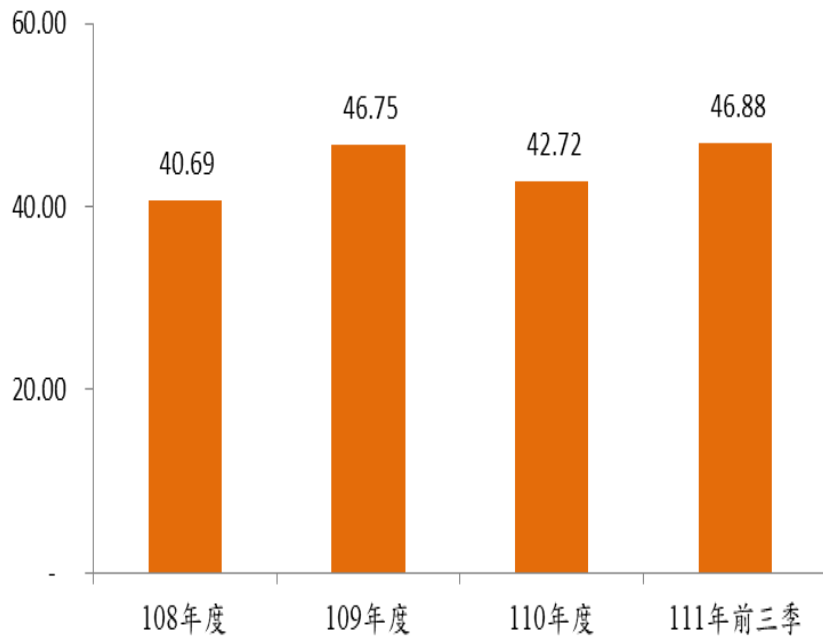


單位：新台幣仟元

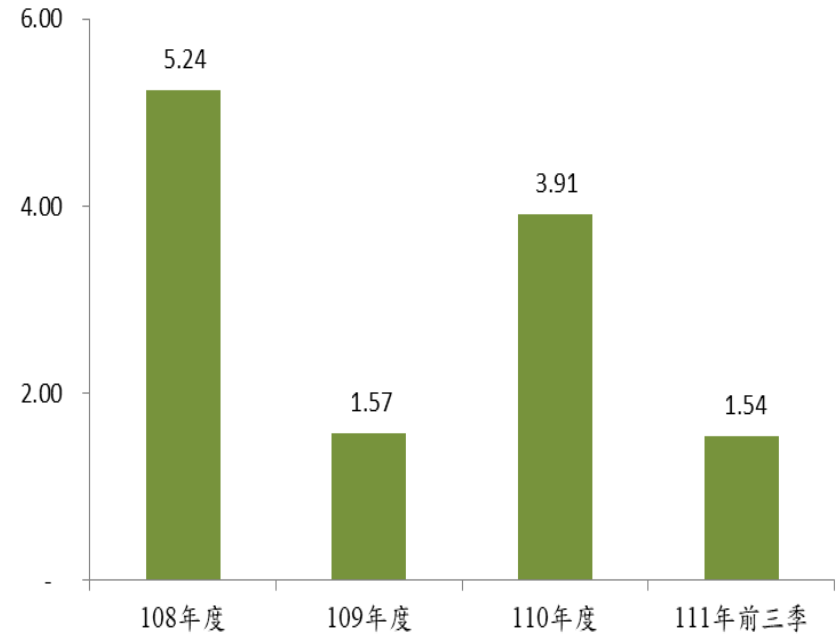
| 年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年前三季 |
|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 營業收入 | 3,017,155 | 2,646,853 | 3,002,859 | 1,692,497 |
| 稅後純益 | 524,347 | 148,328 | 324,411 | 128,017 |

二、營運績效-財務比率分析

負債比例



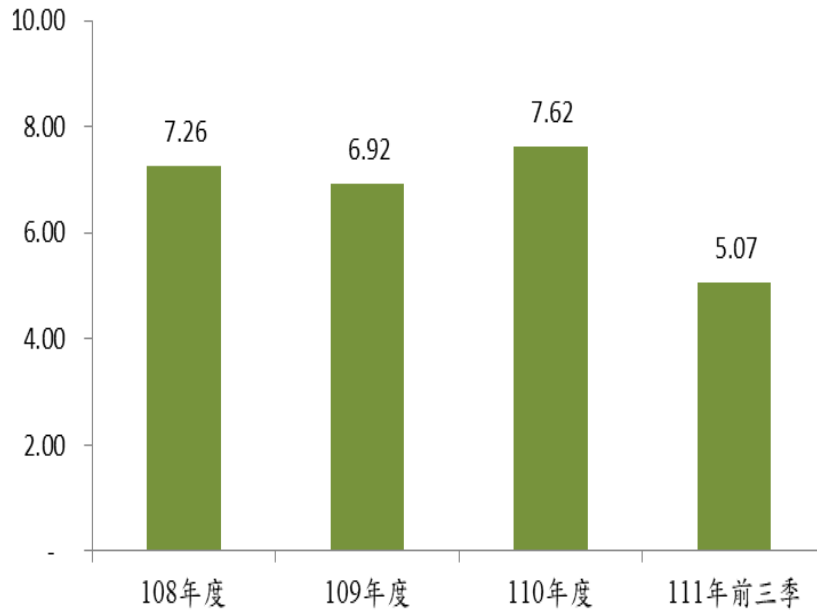
每股盈餘(元)



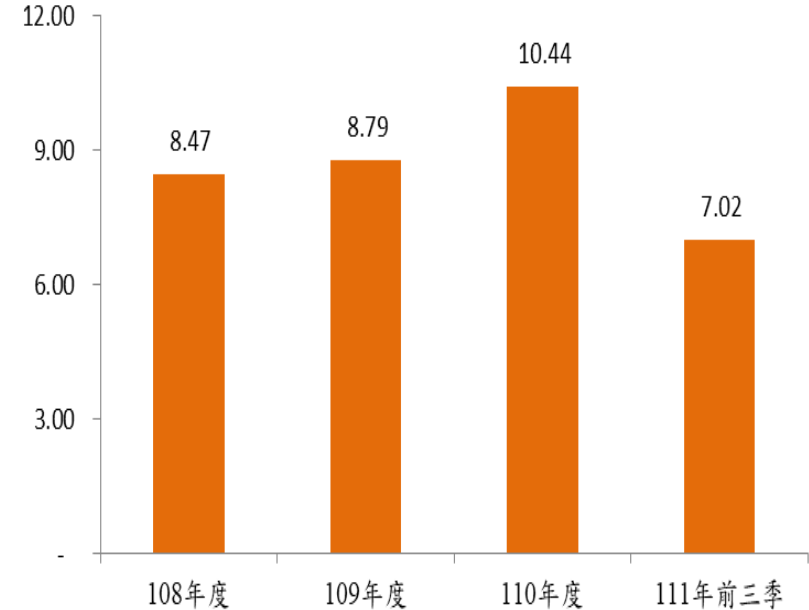
| 年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年前三季 |
|---------|-------|-------|-------|---------|
| 負債比例 | 40.69 | 46.75 | 42.72 | 46.88 |
| 每股盈餘(元) | 5.24 | 1.57 | 3.91 | 1.54 |

二、營運績效-財務比率分析

應收帳款周轉率



存貨周轉率



| 年度 | 108年度 | 109年度 | 110年度 | 111年前三季 |
|---------|-------|-------|-------|---------|
| 應收帳款周轉率 | 7.26 | 6.92 | 7.62 | 5.07 |
| 存貨周轉率 | 8.47 | 8.79 | 10.44 | 7.02 |

三、市場狀況與業務展望-1 Metal COF for 大尺寸面板

✓ 目前：因為新冠肺炎、烏俄戰爭，影響全球通貨膨脹上升

- * 2022年3月中國大陸疫情再起，嚴格封控政策，供應鏈受阻、生產製造活動受到嚴重影響。
- * 加上烏俄戰爭等之地緣性衝突持續不斷，造成終端應用市場雜音不斷。
- * IMF於2022年7月份發布更新的「世界經濟展望」報告再度調降全球2022年和2023年經濟成長預測，分別下修至3.2%與2.9%，主要是美國、中國大陸、印度拖累，三國經濟成長預測下修幅度最大。
- * TV面板及IT面板產值在2020及2021年大幅成長，尤其在2021年，高達3~4成之成長率。但自2022年起，高成長之市場需求下滑，2022至2025年間回歸為穩定需求市場。

✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變；需求時間遞延

- * TV面板 – 4K -> 8K趨勢已然呈現，靜待市場需求。
- * Monitor/NB/Tablet面板 – 開始出現無邊框應用；由COG轉為COF的設計。
- * 車用面板 – 開始COF的設計。

三、市場狀況與業務展望 - 1 Metal COF for小尺寸面板

✓ 目前：手持式裝置用驅動IC設計趨勢更迭

- * 手機面板用驅動IC晶片，因為晶圓產能供應趨緊；加上COP設計增加，因此COF使用量降低。
- * 手錶手環兼具健康管理功能成為顯學，COF在此領域用量需求穩定。

✓ 未來：新設計、新應用…，趨勢不變

- * 高階手機用軟性OLED – COP 增加，1-Metal COF減少
- * 中階手機用硬屏OLED/LTPS – FHD TDDI/FTDDI用1-Metal COF，部分用COG。
- * 低階手機用a-Si/LTPS – HD用COG，FHD TDDI用1-Metal COF。
- * 穿戴裝置 – 由於邊框要求，陸續由COG轉為1-Metal COF設計，市場有成長空間。

三、市場狀況與業務展望 - 2 Metal IC Substrate

✓ 目前：MiniLED直顯和背光市場並進，應用開枝散葉

- * 2021年堪稱Mini LED相關產品增量的一年，加速2022年下世代顯示技術發展。於2022年初CES展會上，各品牌廠積極發表新型顯示器，其中不乏Micro LED相關產品，足見廠商重視先進顯示產品市場發展。
- * 工研院報告指富采透過私募攜手面板雙虎，集結供應鏈力量加速Micro LED儘早導入量產階段，富采整合旗下三大子公司晶電、隆達及晶成的研發能量與技術。
- * 2023年預期Micro LED的開發與應用將更加積極活絡。

✓ 未來：新設計、新應用...

- * 易華2-Metal 技術將成為MiniLED/MicroLED IC Substrate供應商之一。

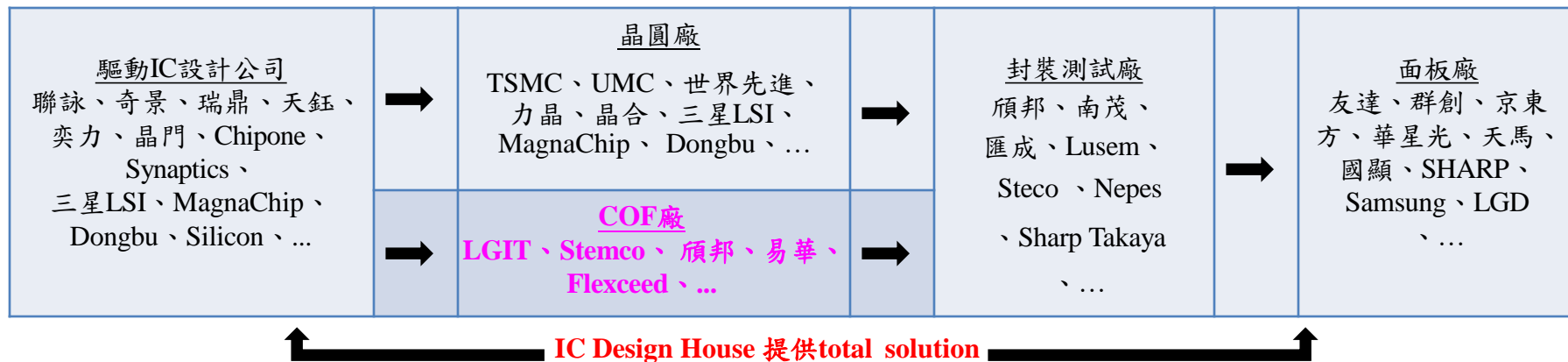
三、市場狀況與業務展望 - 技術與產品開發

✓ 提供客戶全方位軟性IC substrate產品之供應商

| 製程 | 競爭優勢 | 技術/應用 | 目標產品/新產品 |
|-------------------------|---|--|--|
| 1-Metal Sub 減成法 | <ul style="list-style-type: none"> *生產速度快，效率高。 *技術能力自主，生產良率穩定。 | <ul style="list-style-type: none"> *銅厚#~8um *線路>=20um Pitch *腳數=<1440 Channel/48mm | <ul style="list-style-type: none"> @ LCD TV @ OLED TV @ Dual Cell LCD |
| 1-Metal Semi 半加成法 | <ul style="list-style-type: none"> *高精度尺寸控制的COF產品，可以提升面板模組組裝良率；協助客戶降低Total Cost。 *生產良率高及品質穩定性佳，在生產成本上具有絕對的競爭優勢。 | <ul style="list-style-type: none"> *銅厚#~12um *線路>=18/16/14um Pitch *腳數=<1900 Channel/48mm =<3000 Channel/70mm | <ul style="list-style-type: none"> @ 智慧手機 @ 穿戴裝置 @ FoD @ FTDDI |
| 2-Metal 雙面法 | <ul style="list-style-type: none"> *新製程技術開發能力。 *具備設備設計能力。 *成本控制能力佳。 | <ul style="list-style-type: none"> *Thin Film IC Substrate *LED IC Substrate *腳數=<2500 Channel/48mm =<4000 Channel/70mm | <ul style="list-style-type: none"> @ NAND Flash @ Mini LED @ Micro LED |

四、產業概況-驅動IC供應鏈

✓ IC Design House提供total solution



✓ 目前具量產能力的COF廠5家，易華為台灣唯二供應商之一

| 製程技術 | | 1-Metal(單面)減成法 Subtractive(Etching) | 1-Metal(單面)半加成法 Semi-Additive(Plating) | 2-Metal(雙面) | |
|------|----------------|--|---|----------------------|--------|
| 應用 | 腳數(Channel)/帶寬 | =<1400 /48mm | 1400~1900 /48mm | 1900~2500 /48mm | |
| | | =<2000 /70mm | 2000~3000 /70mm | 3000~4000 /70mm | |
| 產能 | 韓國 | S社 | 90~100KK | ?KK(2-Metal改1-Metal) | 7-10KK |
| | | L社 | 120~130KK | ?KK(2-Metal改1-Metal) | 5-7KK |
| | 日本 | F社 | 20KK | X | 2KK |
| | 台灣 | C社 | 70~90KK | X | X |
| | | 易華 | 40KK | 40KK | 5KK |
| | 大陸 | ESWIN Aplus | ? ? | ? ? | ? ? |

Q&A

